



Nächste Lernziele



- Grundlagen MOSFET
- Arbeitsbereiche und wichtige Parameter eines MOSFET
- MOSFET Betrieb im Arbeitspunkt
- Varianten von MOSFETs Umgang mit dem PMOS
- Grundschaltungen mit dem MOSFET
- Aufbau und Betrieb einer MOSFET Differenzstufe

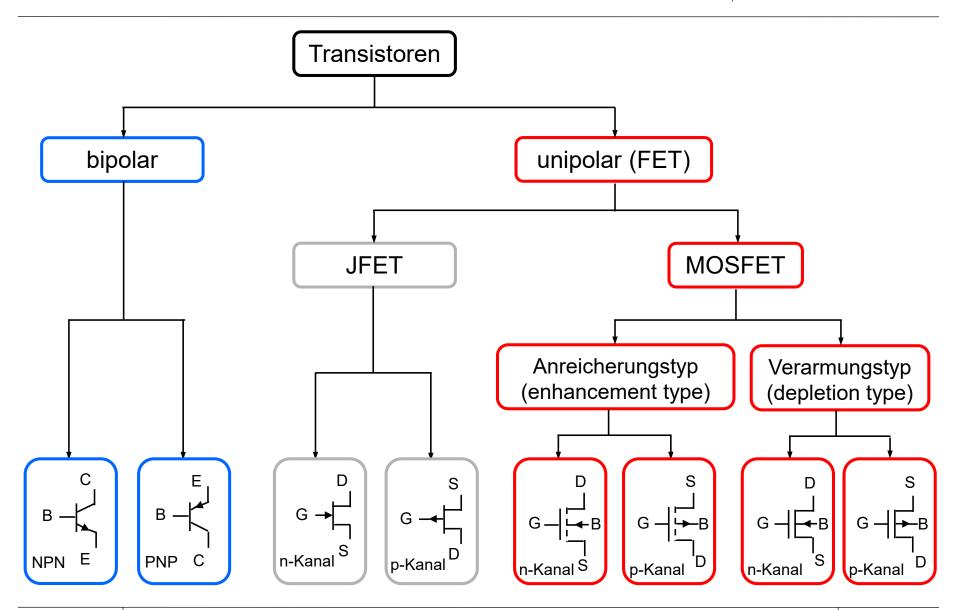
Nächste Lernziele



- Grundlagen MOSFET
 - Aufbau eines MOSFET
 - Betrieb eines MOSFET
 - Arbeitsbereiche eines MOSFET
- Arbeitsbereiche und wichtige Parameter eines MOSFET
- MOSFET Betrieb im Arbeitspunkt
- Varianten von MOSFETs Umgang mit dem PMOS
- Grundschaltungen mit dem MOSFET
- Aufbau und Betrieb einer MOSFET Differenzstufe

Die wichtigsten Transistorarten



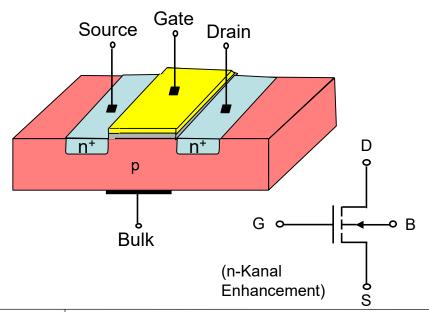


MOSFET

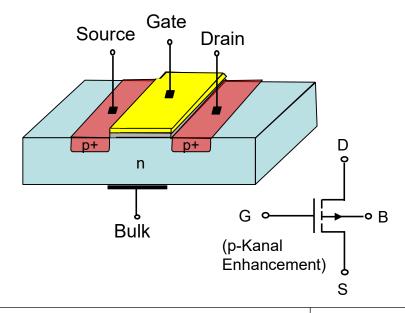


- Feldeffekttransistor (FET): Steuerung des Stroms in einem halbleitenden Kanal durch ein E-Feld. Wichtigster FET-Vertreter ist der ...
- MOSFET = Metal-Oxide Semiconductor-FET (→ Aufbau). Meistverwendeter Transistortyp in hochintegrierten ICs. In diskreter Ausführung (Einzeltransistor) vor allem in der Leistungselektronik von Bedeutung ("Power MOSFET").
- Unipolarer Transistor: Wie bei allen FETs ist am Stromfluss immer nur eine Ladungsträgerart beteiligt. Man unterscheidet dementsprechend zwischen ...

NMOS (n-Kanal-Typ):

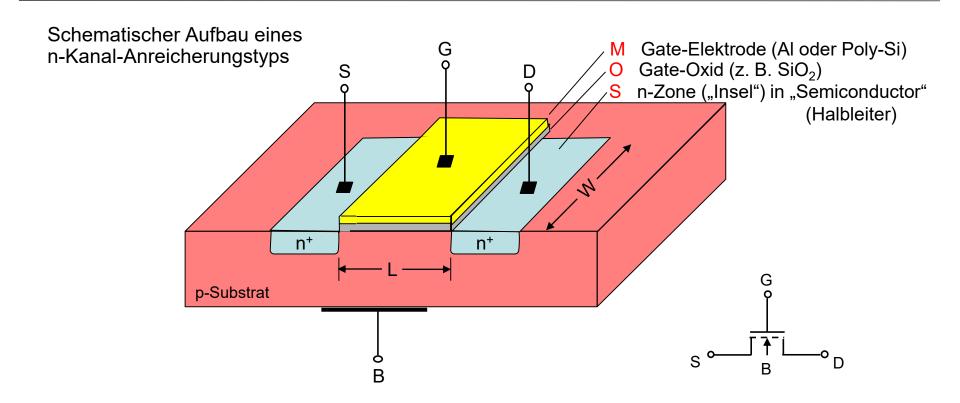


PMOS (p-Kanal-Typ):



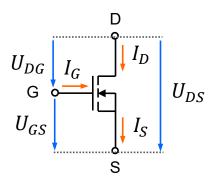
Aufbau des MOSFET

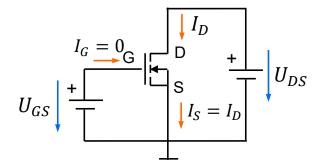




- Der MOSFET ist (im Gegensatz zum BJT) ein symmetrisches Bauteil.
 Drain und Source können daher prinzipiell vertauscht werden.
- G: Gate: Tor, D: Drain: Senke, S: Source: Quelle
- B: Substrat: Material der Silizium-Scheibe (englisch: substrate, bulk, body)

Spannungen und Ströme beim NMOS





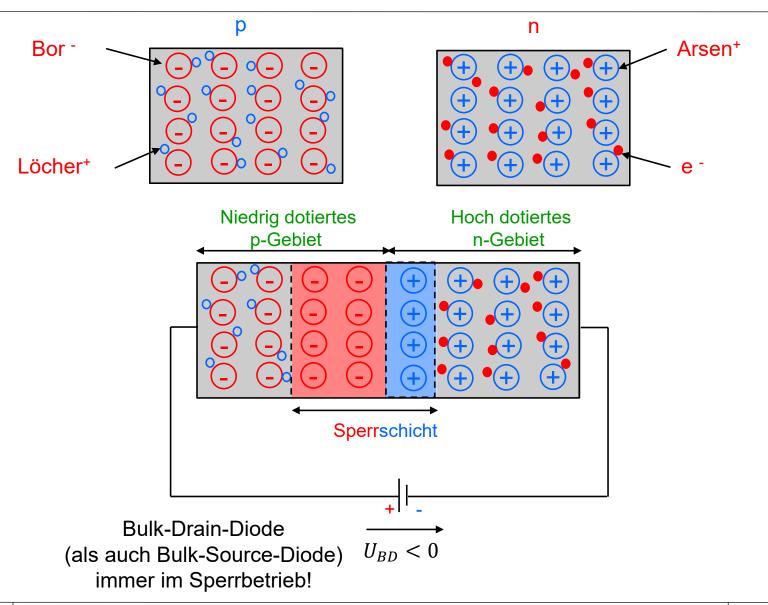
Zählpfeile für Spannungen und Ströme beim n-Kanal-MOSFET

Grundschaltung für den Betrieb des n-Kanal-MOSFET

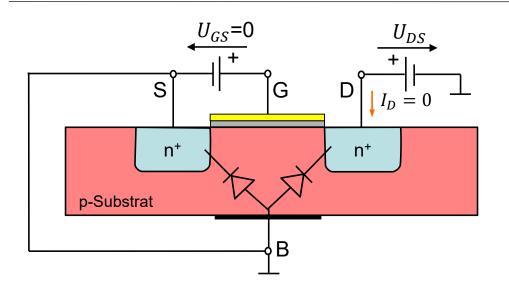
- Der Drain ist stets positiv gegenüber dem Source.
- Der Substrat-Anschluss (Bulk) wird "oft" mit dem Source verbunden.
- Das Gate wirkt als Steuerelektrode: Mit U_{GS} (in weiten Grenzen variierbar) lässt sich der Strom I_D steuern.
- Durch den extrem hohen Eingangswiderstand (Isolationsschicht unter dem Gate) erfolgt die Steuerung praktisch stromlos: $I_G = 0 \Rightarrow I_D = I_S$.

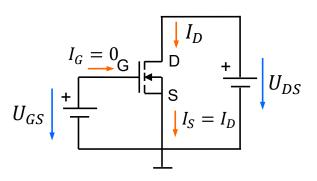
p-Substrat; Drain und Source n-Gebiete: Raumladungszone





Betrieb im Sperrbereich

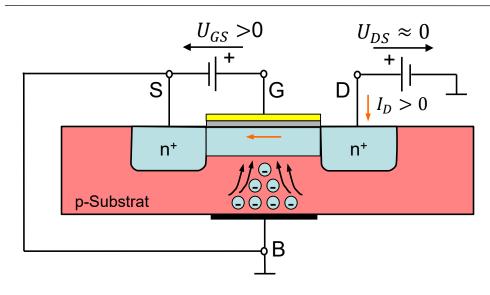




- Der Drain und der Source bilden zusammen mit dem Substrat zwei in Sperrrichtung geschaltete pn-Übergänge (Dioden).
 Daher dürfen Drain und Source NIE negativer als das Substrat werden
- Wird eine positive Spannung am Drain U_{DS} angelegt, fließt kein Strom zwischen Drain und Source, solange $U_{GS}=0$ ist.
- Allgemein gilt: Der Transistor sperrt, solange die Gate-Source-Spannung unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts (threshold voltage) liegt, d. h. $U_{GS} \leq U_T \Longrightarrow I_D = 0$

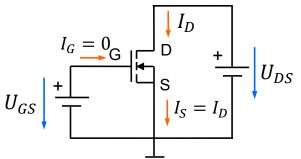
Betrieb im linearen Bereich ($U_{DS} \approx 0$)

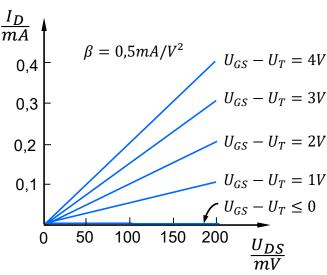




- Für $U_{GS} > U_T$ bildet sich ein n-leitender Kanal unter dem Oxid (Inversionsschicht). $\Rightarrow I_D > 0$
- Bei kleinem U_{DS} nimmt die Dicke des Kanals proportional mit $U_{GSeff} = U_{GS} U_T$ zu (effektive Gate-Source-Spannung, *Overdrive*) $\Rightarrow R_{DS}$ sinkt.

$$\begin{split} I_D \sim & (U_{GS} - U_T), I_D \sim U_{DS} \Longrightarrow I_D = \beta \cdot \underbrace{\left(\underbrace{U_{GS} - U_T}_{=U_{GS \, eff}}\right)} \cdot U_{DS} \\ R_{DS} = & \underbrace{\frac{U_{DS}}{I_D}} = \frac{1}{\beta \cdot (U_{GS} - U_T)} \end{split} \quad \text{(Steuerbarer Widerstand)}$$



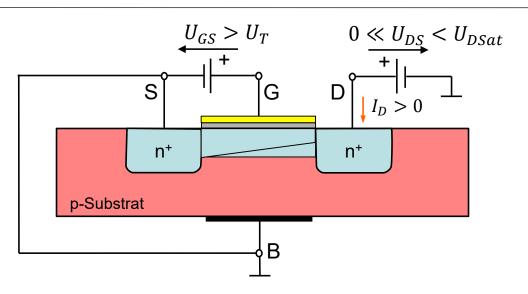


(β ist ein dimensionsbehafteter Proportionalitätsfaktor).

(Nicht mit dem β des bipolar Transistors verwechseln!!)

Betrieb im linearen Bereich ($U_{DS} \gg 0$)

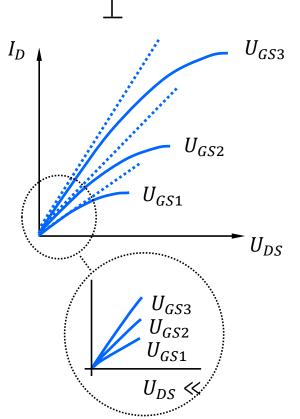




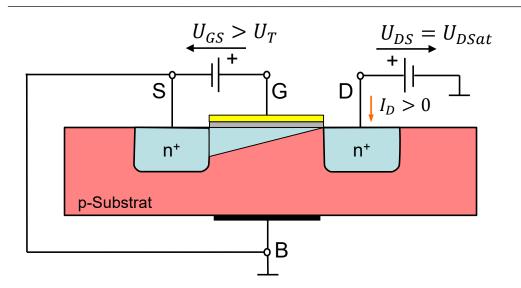
 $U_{GS} \downarrow \stackrel{I_G}{\longrightarrow} \stackrel{G}{\longrightarrow} \stackrel{I_D}{\longrightarrow} U_{DS}$

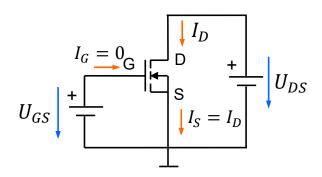
- Die Kanaldicke an einem bestimmten Punkt hängt ab vom Potentialunterschied zwischen dem Gate und diesem Punkt im Kanal.
- Für $U_{DS}\gg 0$ kommt es daher zu einer keilförmigen Verengung, weil das Potential entlang des Kanals vom Source zum Drain hin ansteigt. Bis zum Eintritt der sog. Sättigung gilt:

$$I_D = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_T) - \frac{U_{DS}}{2} \right] \cdot U_{DS} \quad \text{quadr. Term} \\ \rightarrow \text{Parabeläste}$$



Grenze zum Sättigungsbereich





- Bei $U_{DS} = U_{DSsat}$ ist der Kanal (für ein gegebenes U_{GS}) vollständig abgeschnürt.
- Die Abschnürgrenze ist erreicht, wenn der Potentialunterschied zwischen dem Gate und dem Kanal am drainseitigen Ende gerade gleich U_T ist, d. h.

 $U_{GD}=U_{T}$ Allgemein gilt: $U_{GD}=U_{GS}-U_{DS}$, und somit ergibt sich für die Drain-Source-Sättigungsspannung $U_{DS}=U_{DSsat}$:

$$U_{DSsat} = U_{GS} - U_{T} = U_{GSeff}$$

Abschnürspannung "pinch-off-voltage"

Betrieb im Sättigungsbereich



Wir berechnen nun das Maximum der Funktion $I_D = I_D(U_{DS})$ für gegebenes U_{GS} :

$$I_D = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial U_{DS}} = \beta \cdot [(U_{GS} - U_T) - U_{DS}] = 0$$

$$\Rightarrow U_{DS} = U_{GS} - U_T =: U_{DSsat}$$
 $\stackrel{\sqrt{}}{}$ mathematisch bestätigt

Für den Strom im Scheitelpunkt eines Parabelasts gilt somit:

Linearbereich (Abschnürbereich)

$$U_{GS3}$$

Abschnürpunkt

 U_{GS2}
 U_{GS1}
 U_{DS}
 U_{DS}

$$I_{D} = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_{T}) \cdot (U_{GS} - U_{T}) - \frac{(U_{GS} - U_{T})^{2}}{2} \right]$$

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2$$

Im Abschnürpunkt $(U_{DS} = U_{DSsat})$ erreicht der Strom einen Sättigungswert. Eine weitere Erhöhung von U_{DS} führt nicht mehr zu einer wesentlichen Zunahme von I_D (Kennlinie flach).

Nächste Lernziele



- Grundlagen MOSFET
- Arbeitsbereiche und wichtige Parameter eines MOSFET
 - Stromgleichungen
 - Steilheitskoeffizient β ein wichtiger Designparameter
 - Ermittlung und Bedeutung der Arbeitsbereiche
 - Kanallängenmodulation
 - Differentieller Ausgangswiderstand
 - Grenzbereiche für Zerstörungsfreien Betrieb
- MOSFET Betrieb im Arbeitspunkt
- Varianten von MOSFETs Umgang mit dem PMOS
- Grundschaltungen mit dem MOSFET
- Aufbau und Betrieb einer MOSFET Differenzstufe

Stromgleichungen für alle Arbeitsbereiche



• Sperrbereich: für $U_{GS} \leq U_T$

$$I_D=0$$

• Linearbereich: für $U_{GS} > U_T$,

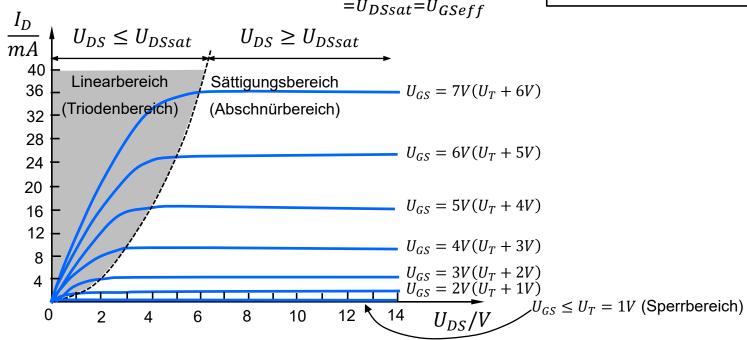
$$0 \le U_{DS} \le \underbrace{\left(U_{GS} - U_{T}\right)}_{=U_{DSsat} = U_{GSeff}}$$

$$I_D = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

• Sättigungsbereich: für $U_{GS} > U_T$,

$$U_{DS} \ge \underbrace{(U_{GS} - U_T)}_{=U_{DSsat} = U_{GSeff}}$$

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2$$



Der Parameter β

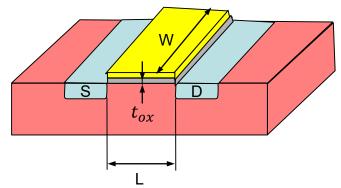


Die Größe β wird als Steilheitskoeffizient bezeichnet:

$$\beta = \beta_0 \cdot \frac{W}{L} = \mu \cdot \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} \qquad \beta \ in \ \frac{A}{V^2} \qquad \text{Bipolar}$$

$$\beta$$
 in $\frac{A}{V^2}$





Breite des Kanals (*width*) in μm

Länge des Kanals (*length*) in µm

W/L bezeichnet man häufig als Aspektverhältnis

relativer Steilheitskoeffizient (in SPICE: KP)

$$\beta_0 = \mu \cdot \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

n-Kanal: $\mu = \mu_n \approx 500 ... 700 cm^2/Vs$

p-Kanal: $\mu = \mu_p \approx 150 ... 300 \ cm^2/Vs$

Beweglichkeit der Ladungen im Kanal

 t_{ox} Dicke des Gate-Oxids (oxide thickness)

 $\varepsilon_{ox} = 34.5 \cdot 10^{-12} F/m$ Dielektrizitätskonstante für SiO₂

 $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} F/m$ el. Feldkonstante

 $\varepsilon_{r,ox} = 3.9$ Dielektrizitätszahl für SiO₂

Bedeutung der einzelnen Arbeitsbereiche



In der schaltungstechnischen Praxis lassen sich die verschiedenen Arbeitsbereiche wie folgt nutzen:

- Sperrbereich: Einsatz als Schalter ("on"/"off")
- Linearbereich: Einsatz als spannungsgesteuerter Widerstand.
- Sättigungsbereich: Einsatz als Verstärker
 → spannungsgesteuerte Stromquelle

In der analogen Schaltungstechnik werden MOSFETs am häufigsten im Sättigungsbereich betrieben (entsprechend dem aktiven Bereich beim BJT).

Ermittlung des Arbeitsbereichs

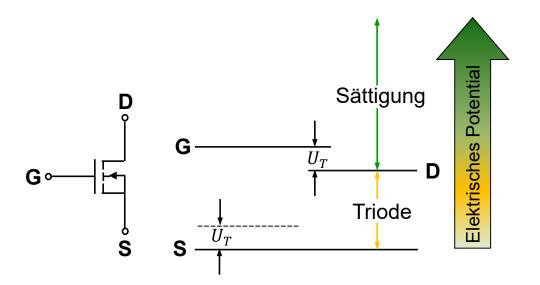


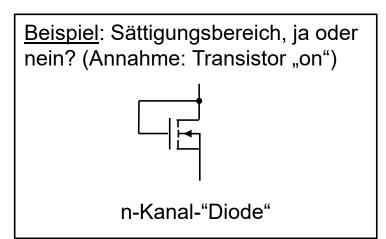
- Frage: Wie findet man heraus, in welchem der 3 Betriebszustände sich ein Transistor befindet?
 - 1. Prüfe, ob der Transistor gesperrt ist. (Sehr einfach: $U_{GS} > U_T$?)
 - 2. Ist der Transistor nicht gesperrt und sein Arbeitsbereich nicht bekannt oder kann nicht ermittelt werden, machen wir die Annahme, dass er in der Sättigung arbeitet. Hier kann der Strom an Hand der Spannung U_{GS} , oder umgekehrt U_{GS} an Hand des Stromes berechnet werden.
 - 3. Falls das Ergebnis nicht physikalisch sinnvoll ist,
 liegt ein Widerspruch zur Annahme vor.
 ⇒ Der Transistor arbeitet also nicht im Sättigungsbereich,
 sondern im linearen Bereich.

Erkennen des Sättigungsbereichs



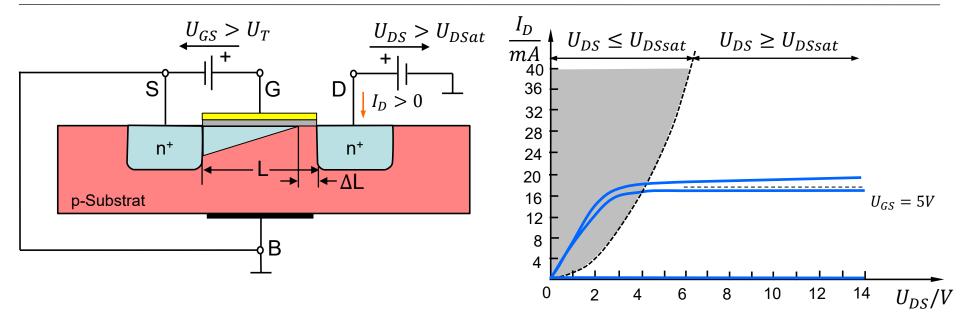
- Frage: Wie erkennt man auf Anhieb, ob ein MOSFET im Sättigungsbereich arbeitet?
 - Im Sättigungsbereich gilt: $U_{DS} \ge U_{DSsat} = U_{GSeff} = U_{GS} U_{T}$ (wobei $U_{GS} > U_{T}$)
 - \Rightarrow $U_D > U_G U_T \Rightarrow U_{GD} < U_T$





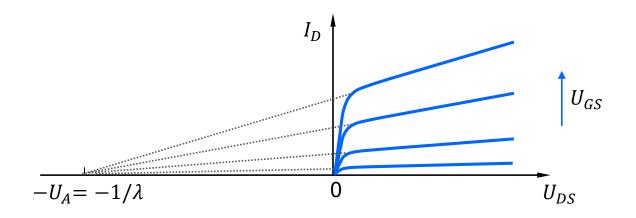
Der Drain darf höchstens um U_T tiefer liegen als das Gate.

Kanallängenmodulation



- Kanallängenmodulation: In realen MOSFETs führt $U_{DS} > U_{DSsat}$ zu einer Verkürzung des abgeschnürten Kanals. (Ursache: Ausdehnung der Drain-Sperrschicht).
- Abnahme der effektiven Kanallänge: $L_{eff} = L \Delta L \rightarrow \beta = \beta_0 \cdot (W/L_{eff}) \uparrow$
- Die Ausgangskennlinien im Sättigungsbereich verlaufen daher nicht ganz waagerecht $I_D \Rightarrow$ steigt mit U_{DS} leicht an \Rightarrow endliches r_{DS} (differentieller Ausgangswiderstand).

Kanallängen-Modulationsparameter

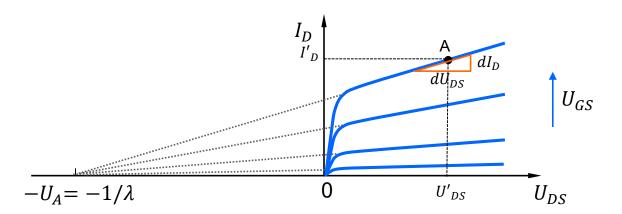


- Auch beim MOSFET gilt: Die extrapolierten Ausgangskennlinien schneiden sich näherungsweise in einem gemeinsamen Fußpunkt auf der U_{DS} -Achse.
- Die positive Konstante U_A wird in Anlehnung an den BJT auch hier als Early-Spannung bezeichnet. Typische Werte $U_A = 30 \dots 150V$.
- Alternativ wird dem MOSFET häufig der Kanallängen-Modulationsparameter λ verwendet:

$$\lambda = \frac{1}{U_A}$$

Differentieller Ausgangswiderstand r_{DS}





 Für den differentiellen Ausgangswiderstand im Sättigungsbereich ergibt sich analog zum Bipolartransistor:

$$r_{DS} = \frac{dU_{DS}}{dI_D}\Big|_{A} \approx \frac{U_A}{I'_D} = \frac{1}{\lambda \cdot I'_D} \Longrightarrow r_{DS} \propto \frac{1}{I'_D}$$

• Der Einfluss von U_{DS} auf I_D im Sättigungsbereich lässt sich durch einen zusätzlichen Term in der Stromgleichung berücksichtigen (vgl. Kap. 3):

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2 \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}) = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2 \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{U_A}\right)$$
 Sättigungsbereich

• Für einen stetigen Übergang zwischen den Arbeitsbereichen muss auch die Stromgleichung des Linearbereichs entsprechend ergänzt werden:

$$I_D = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right] \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS})$$
 Linearbereich

Steuerkennlinie $I_D = f(U_{GS})$



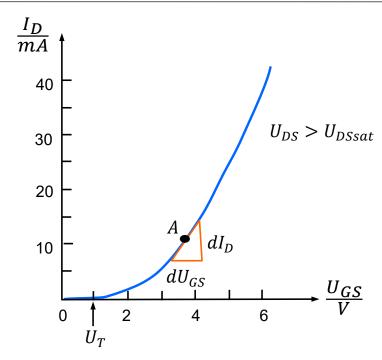
Im Sättigungsbereich gilt:

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2$$

Die Steilheit oder Transconductance beschreibt die Steuerwirkung des Transistors im Arbeitspunkt:

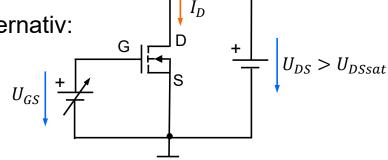
$$g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}}\bigg|_A = \beta \cdot (U_{GS} - U_T)$$

$$g_m = \beta \cdot U_{GSeff} = \frac{2I_D}{U_{GSeff}}$$



Wird U_{GSeff} durch I_D ausgedrückt, erhält man alternativ:

$$g_m = \sqrt{2 \cdot \beta \cdot I_D}$$

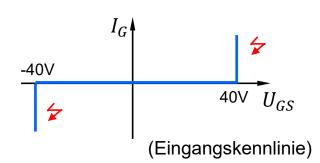


Grenzbereich

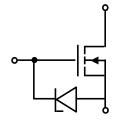


- Verlustleistung: $P_V = U_{DS} \cdot I_D \le P_{Vmax}$ (\rightarrow Verlustleistungshyperbel im Ausgangskennlinienfeld)
- Draindurchbruch: U_{DSmax} (\rightarrow Durchbruchgebiet im Ausgangskennlinienfeld)

Durchschlag des Gate-Oxids: U_{GSmax} Übersteigt die Feldstärke einen kritischen Wert, schlägt die dünne Isolation durch und das Bauteil wird zerstört.



 Durch seinen extrem hohen Eingangswiderstand ist der MOSFET sehr empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD)! Häufig werden deshalb Dioden zum Überspannungsschutz integriert.



Nächste Lernziele

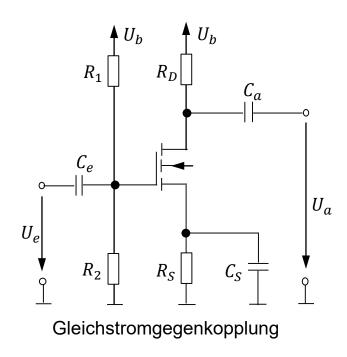


- Grundlagen MOSFET
- Arbeitsbereiche und wichtige Parameter eines MOSFET
- MOSFET Betrieb im Arbeitspunkt
 - Arbeitspunkteinstellung mit Stromgegenkopplung
 - Spezielle Schaltungen zur Arbeitspunkteinstellung
- Varianten von MOSFETs Umgang mit dem PMOS
- Grundschaltungen mit dem MOSFET
- Aufbau und Betrieb einer MOSFET Differenzstufe

MOSFET – Grundschaltungen

Arbeitspunkteinstellung mit Stromgegenkopplung



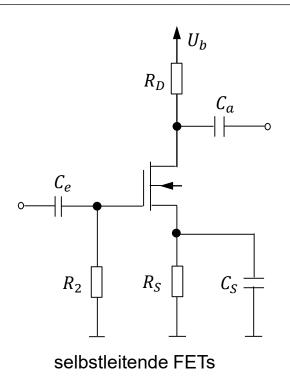


- Kleinsignalverstärker in Sourceschaltung: im Vergleich zur Emitterschaltung geringe Verstärkung, aber vorteilhaft für sehr hochohmige Signalquellen
- Arbeitspunkteinstellung: Koppelkondensatoren verbinden Signalquelle und Last
- Gleichstromgegenkopplung: entspricht der Arbeitspunkteinstellung bei Emitterschaltung

MOSFET – Grundschaltungen

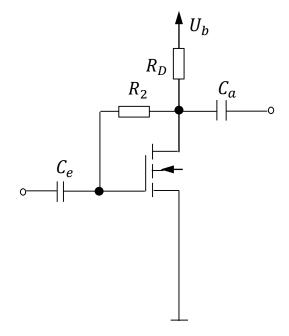
Spezielle Schaltungen zur Arbeitspunkteinstellung





Aus der Bedingung $U_{GS} = -I_D R_S$ und der Gleichung für den Abschnürbereich ergibt sich die Dimensionierung:

$$R_{S} = \frac{|U_{T}|}{I_{D,A}} \left(1 - \sqrt{\frac{2I_{D,A}}{\beta U_{T}^{2}}} \right) = \frac{|U_{T}|}{I_{D,A}} \left(1 - \sqrt{\frac{I_{D,A}}{I_{D,A(max)}}} \right)$$



selbstsperrende FETs

Selbstsperrende MOSFETs kann man mit $U_{GS} = U_{DS}$ im Abschnürbereich betreiben; da kein Gatestrom fließt, kann man den Widerstand R_2 so groß machen, dass die durch R_2 verursachte Spannungsgegenkopplung vernachlässigbar gering ist.

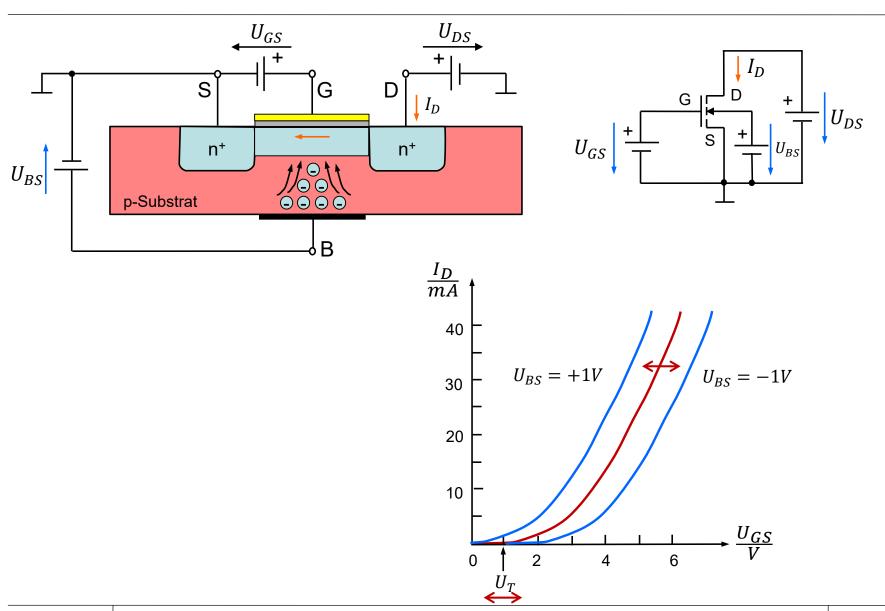
27

Nächste Lernziele

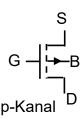


- Grundlagen MOSFET
- Arbeitsbereiche und wichtige Parameter eines MOSFET
- MOSFET Betrieb im Arbeitspunkt
- Varianten von MOSFETs Umgang mit dem PMOS
- Grundschaltungen mit dem MOSFET
- Aufbau und Betrieb einer MOSFET Differenzstufe

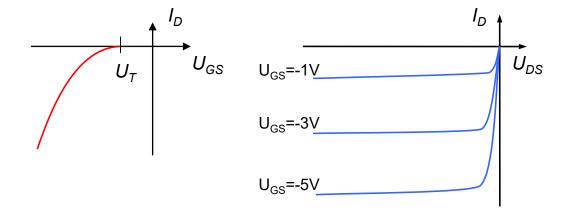
Substratsteuerung



Varianten von MOSFETs – Umgang mit dem PMOS

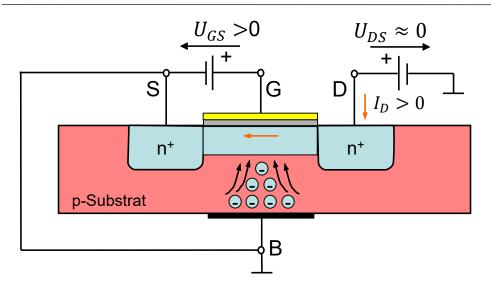


Die Kennlinien eines p-Kanal-MOSFETs erhält man, indem man das Ausgangs- und das Übertragungskennlinienfeld eines n-Kanal-MOSFETs jeweils am Ursprung spiegelt. In den Gleichungen hat diese Punktspiegelung eine Änderung der Polarität aller Spannungen und Ströme zur Folge.



MOSFET als steuerbarer Widerstand im Linearbereich ($U_{DS} \approx 0$)

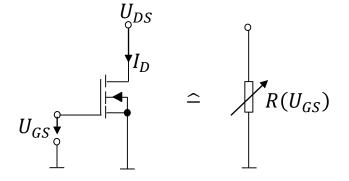


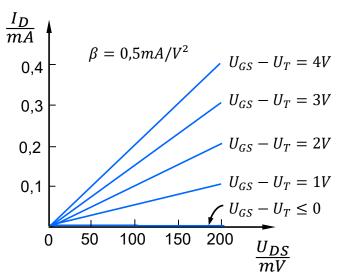


- Für $U_{GS} > U_T$ bildet sich ein n-leitender Kanal unter dem Oxid (Inversionsschicht). $\Rightarrow I_D > 0$
- Bei kleinem U_{DS} nimmt die Dicke des Kanals proportional mit $U_{GSeff} = U_{GS} - U_T$ zu (effektive Gate-Source-Spannung, Overdrive) $\Rightarrow R_{DS}$ sinkt.

$$I_D \sim (U_{GS} - U_T), I_D \sim U_{DS} \Longrightarrow I_D = \beta \cdot \left(\underbrace{U_{GS} - U_T}_{=U_{GS \, eff}}\right) \cdot U_{DS}$$

$$R_{DS} = \frac{U_{DS}}{I_D} = \frac{1}{\beta \cdot (U_{GS} - U_T)}$$
 steuerbarer Widerstand

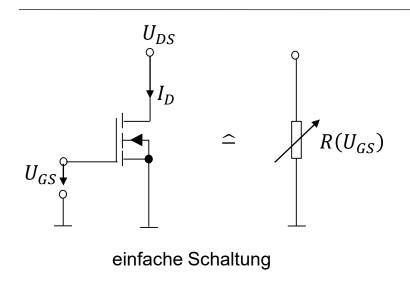


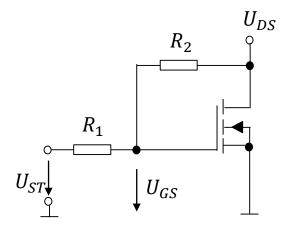


(β ist ein dimensionsbehafteter Proportionalitätsfaktor).

MOSFET als steuerbarer Widerstand im Linearbereich ($U_{DS} > 0$)







linearisierte Schaltung

$$U_{GS}$$
 in Gleichung für den Linearbereich von Seite 22 einfügen

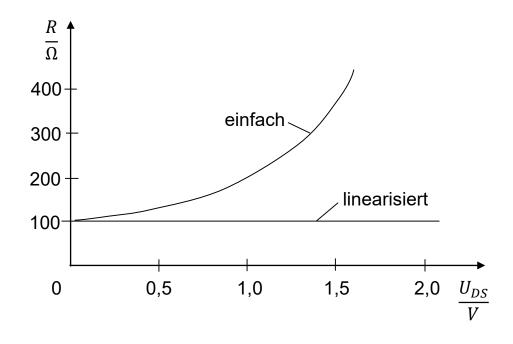
$$U_{GS} = \frac{U_{DS}R_1 + U_{ST}R_2}{R_1 + R_2} \qquad R_1 = R_2 \qquad \frac{U_{DS} + U_{ST}}{2}$$

$$I_D = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right] \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS})$$

$$I_D = \beta U_{DS} \left(\frac{U_{ST}}{2} - U_T \right) (1 + \lambda \cdot U_{DS})$$

$$\frac{1}{R(U_{ST})} = \beta \left(\frac{U_{ST}}{2} - U_T\right) \left(1 + \frac{U_{DS}}{U_A}\right) \quad U_{DS} \ll U_A \qquad \beta \left(\frac{U_{ST}}{2} - U_T\right)$$

MOSFET als steuerbarer Widerstand

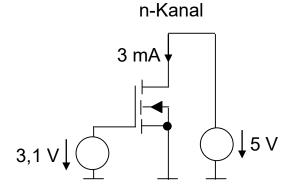


Vergleich der Widerstandsverläufe für β = 5mA/V², U_T = 2 V, U_A = 100 V und U_{GS} = 4 V bzw. U_{ST} = 8V

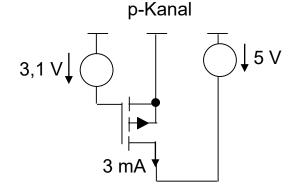
Arbeitspunkt und Kleinsignalverhalten



MOSFET, selbstsperrend

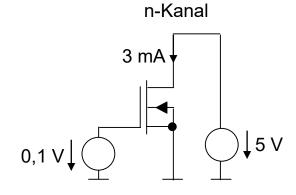


$$U_{GS} = 3.1V > U_T = 2V$$

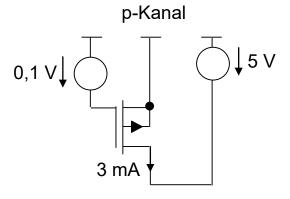


$$U_{GS} = -3.1V < U_T = -2V$$

MOSFET, selbstleitend



$$U_{GS} = 0.1V > U_T = -1V$$



$$U_{GS} = -0.1V < U_T = 1V$$

Arbeitspunkt und Kleinsignalverhalten Steuerkennlinie $I_D = f(U_{GS})$



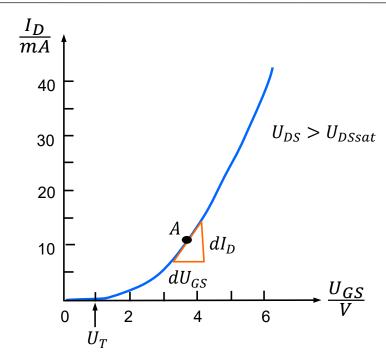
Im Sättigungsbereich gilt:

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2$$

Die Steilheit oder Transconductance beschreibt die Steuerwirkung des Transistors im Arbeitspunkt:

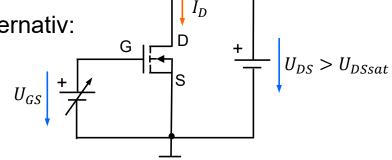
$$g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}}\bigg|_A = \beta \cdot (U_{GS} - U_T)$$

$$g_m = \beta \cdot U_{GSeff} = \frac{2I_D}{U_{GSeff}}$$



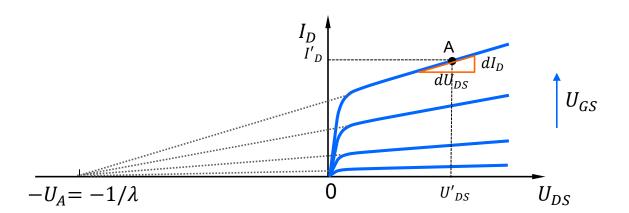
Wird U_{GSeff} durch I_D ausgedrückt, erhält man alternativ:

$$g_m = \sqrt{2 \cdot \beta \cdot I_D}$$



Arbeitspunkt und Kleinsignalverhalten Differentieller Ausgangswiderstand r_{DS}





 Für den differentiellen Ausgangswiderstand im Sättigungsbereich ergibt sich analog zum Bipolartransistor:

$$r_{DS} = \frac{dU_{DS}}{dI_D}\Big|_{A} \approx \frac{U_A}{I'_D} = \frac{1}{\lambda \cdot I'_D} \Longrightarrow r_{DS} \propto \frac{1}{I'_D}$$

• Der Einfluss von U_{DS} auf I_D im Sättigungsbereich lässt sich durch einen zusätzlichen Term in der Stromgleichung berücksichtigen (vgl. Kap. 3):

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2 \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}) = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2 \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{U_A}\right)$$
 Sättigungsbereich

• Für einen stetigen Übergang zwischen den Arbeitsbereichen muss auch die Stromgleichung des Linearbereichs entsprechend ergänzt werden:

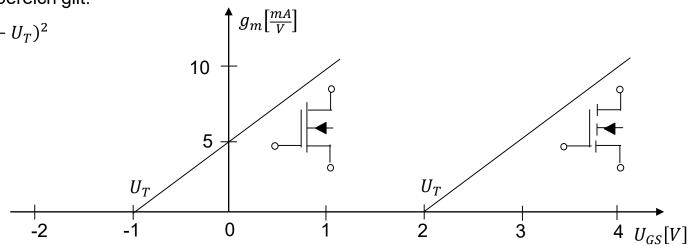
$$I_D = \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_T) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right] \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS})$$
 Linearbereich

Arbeitspunkt und Kleinsignalverhalten



Im Sättigungsbereich gilt:

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_T)^2$$



$$g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}}\bigg|_A = \beta \cdot (U_{GS} - U_T)$$

$$g_m = \beta \cdot U_{GSeff} = \frac{2I_D}{U_{GSeff}}$$

Die Steilheit g_m ist proportional zum Steilheitskoeffizienten β . Man erhält Geraden mit dem x-Achsen-Abschnitt U_T und der Steigung β .

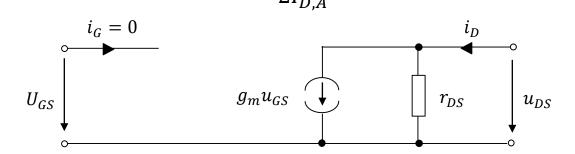
Arbeitspunkt und Kleinsignalverhalten



$$g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}}\Big|_A = \sqrt{2\beta I_{D,A} \left(1 + \frac{U_{DS,A}}{U_A}\right)} \quad U_{DS,A} \ll U_A \qquad \sqrt{2\beta I_{D,A}}$$

Im Gegensatz zum Bipolartransistor, bei dem man zur Berechnung der Steilheit nur den Kollektorstrom $I_{C,A}$ benötigt, wird beim Feldeffekttransistor zusätzlich zum Drainstrom $I_{D,A}$ der Steilheitskoeffizient β benötigt; die Abhängigkeit von U_A bzw. $1/\lambda$ ist dagegen gering. In der Praxis arbeitet man mit der angegebenen Näherung. In Datenblättern ist anstelle von β die Steilheit für einen bestimmten Drainstrom angegeben; man kann β in diesem Fall aus der Steilheit ermitteln:

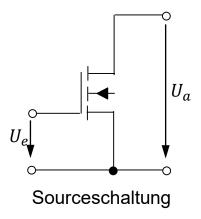
Kleinsignalersatz-Schaltbild eines Feldeffekttransistors

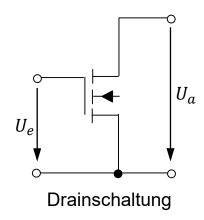


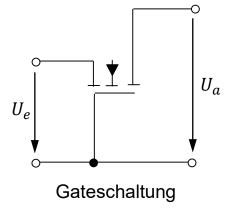
$$r_{DS} = \frac{dU_{DS}}{dI_D} \bigg|_A = \frac{U_A + U_{DS,A}}{I_{D,A}} \qquad \qquad U_{DS,A} \ll U_A \approx \frac{U_A}{I_{D,A}}$$

Grundschaltungen eines Feldeffekttransistors



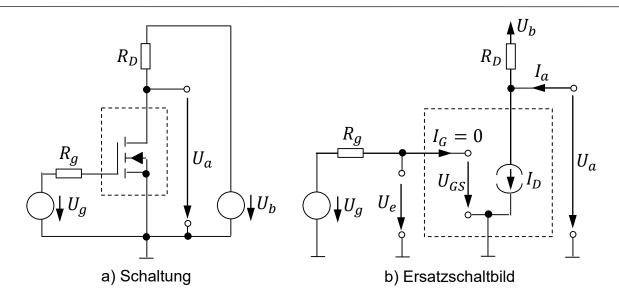






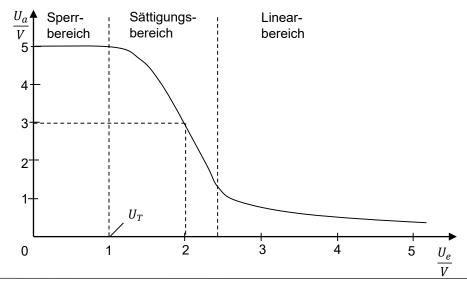
Sourceschaltung





Im Sättigungsbereich gilt unter Vernachlässigung der Kanallängenmodulation:

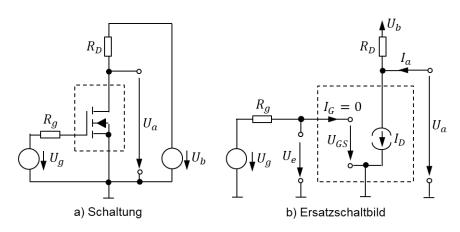
$$I_D = \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_T)^2$$

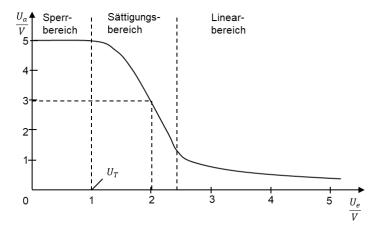


Übertragungskennlinie der Sourceschaltung

Grundschaltungen







Für die Ausgangsspannung gilt mit $U_g = U_e = U_{GS}$:

$$U_a = U_{DS}$$
 $I_{aus} = 0$ $I_b - I_D R_D = U_b - \frac{R_D \beta}{2} (U_e - U_T)^2$

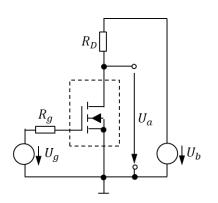
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline \text{Bsp. } U_a = 3V, R_D = 1k\Omega,\\ \beta = \frac{4mA}{V^2}, U_T = 1V \end{array} \Rightarrow I_D = \frac{U_b - U_a}{R_D} = 2mA \Rightarrow U_e = U_{GS} = U_T + \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}} = 2V$$

Grenze zum Linearbereich:

$$U_{a.ab} = \frac{1}{R_D \beta} \left(\sqrt{1 + 2U_b R_D \beta} - 1 \right) \qquad \stackrel{2U_b R_D \beta}{\approx} \gg 1 \qquad \sqrt{\frac{2U_b}{R_D \beta}} - \frac{1}{R_D \beta}$$

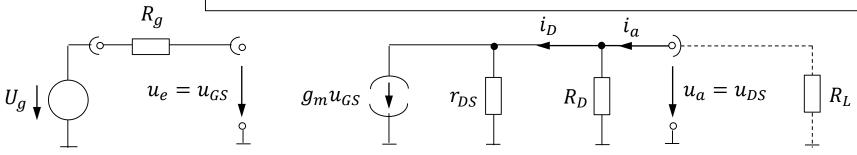
Kleinsignalverhalten der Sourceschaltung





Das Verhalten bei Aussteuerung um einen Arbeitspunkt A wird als Kleinsignalverhalten bezeichnet. Der Arbeitspunkt ist durch die Arbeitspunktgrößen $U_{e,A} = U_{GS,A}$, $U_{a,A} = U_{DS,A}$ und $I_{D,A}$ gegeben und muss im Sättigungsbereich liegen, damit eine nennenswerte Verstärkung erreicht wird:

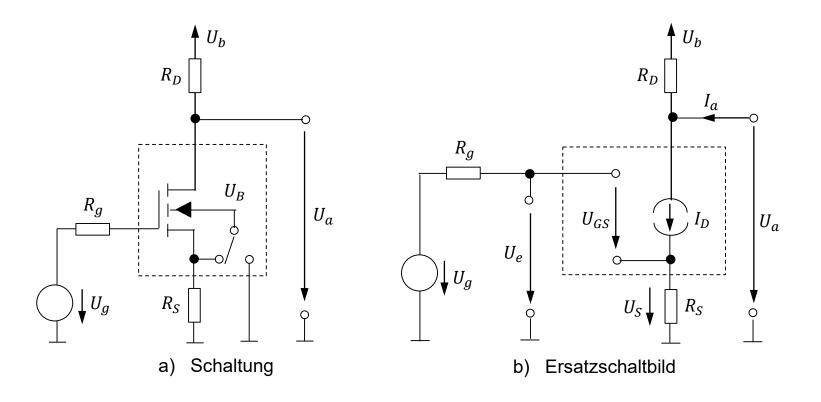
$$\begin{vmatrix} A = \frac{u_a}{u_e} \Big|_{i_a = 0} = -g_m(R_D || r_{DS}) & r_{DS} \gg R_D \\ r_e = \frac{u_e}{i_e} = \infty \\ r_a = \frac{u_a}{i_a} = R_D || r_{DS} & r_{DS} \gg R_D \\ \approx & R_D \end{vmatrix}$$



Kleinsignalersatzschaltbild der Sourceschaltung

Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung





$$U_a = U_b - I_D R_D = U_b - \frac{R_D \beta}{2} (U_{GS} - U_T)^2$$

$$U_e = U_{GS} + U_S = U_{GS} + I_D R_S$$

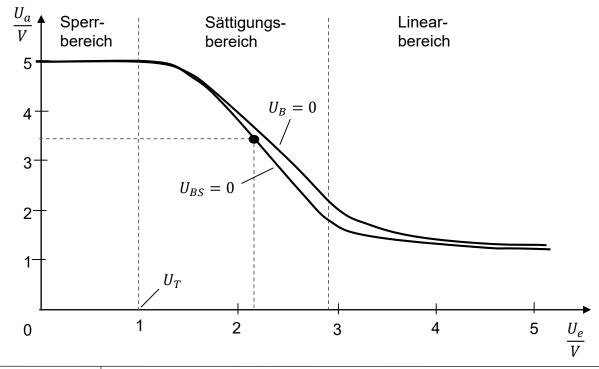




Für den beispielhaft eingezeichneten Arbeitspunkt erhält man mit $U_b=5V$, $\beta=4\frac{mA}{V^2}$, $R_D=1k\Omega$, $R_S=200\Omega$ beim Einzel-MOSFET:

$$U_a = 3.5 V \Rightarrow I_D = -\frac{U_b - U_a}{R_D} = 1.5 \text{ mA} \Rightarrow U_S = I_D R_S = 0.3V$$

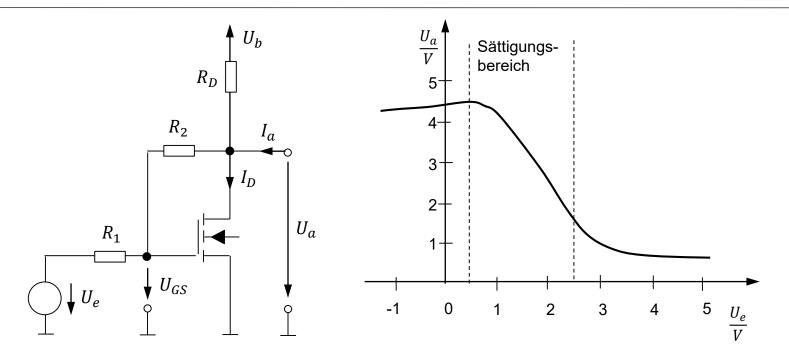
$$\Rightarrow U_{GS} = U_T + \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}} = 1,866 V \Rightarrow U_e = U_{GS} + U_S = 2,166 V$$



Übertragungskennlinie der Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung bei einem Einzel-MOSFET ($U_{BS} = 0$) und einem integrierten MOSFET ($U_B = 0$); Grenze Sättigungs-/ Linearbereich für Einzel-MOSFET



Sourceschaltung mit Spannungsgegenkopplung



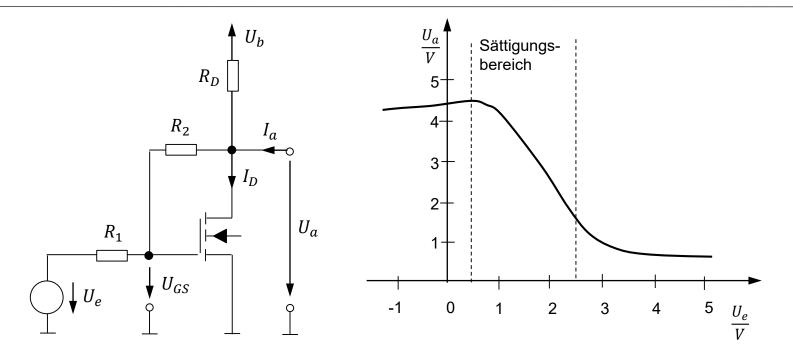
Bei der Sourceschaltung mit Spannungsgegenkopplung wird ein Teil der Ausgangsspannung über die Widerstände R_1 und R_2 auf das Gate des FETs zurückgeführt; U_b = 5 V, R_D = R_1 = 1 k Ω , R_2 = 6,3 k Ω und β = 4 mA/V². Betrieb im Abschnürbereich:

$$\frac{U_b - U_a}{R_D} + I_a = I_D + \frac{U_a - U_{GS}}{R_2}$$

$$\frac{U_{GS} - U_e}{R_1} = \frac{U_a - U_{GS}}{R_2}$$



Sourceschaltung mit Spannungsgegenkopplung



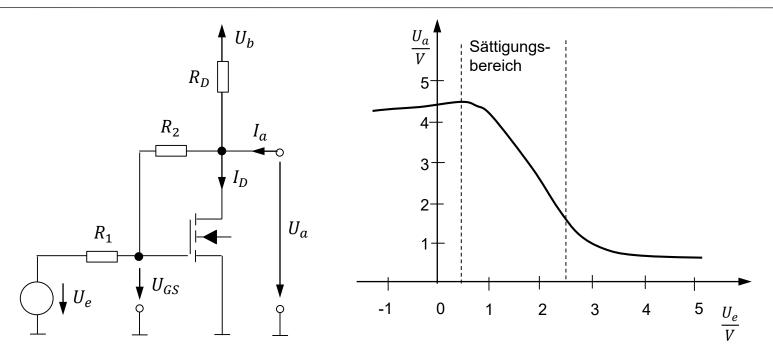
Für den Betrieb ohne Last, d.h. I_a=0 gilt:

$$U_{a} = \frac{U_{b}R_{2} - I_{D}R_{D}R_{2} + U_{GS}R_{D}}{R_{2} + R_{D}} \qquad R_{2} \gg R_{D} \approx U_{b} - I_{D}R_{D}$$

$$U_{e} = \frac{U_{GS}(R_{1} + R_{2}) - U_{a}R_{1}}{R_{2}}$$



Sourceschaltung mit Spannungsgegenkopplung



Mit der Näherung und der Vorgabe $U_{a,A}$ = 2,5 V erhält man:

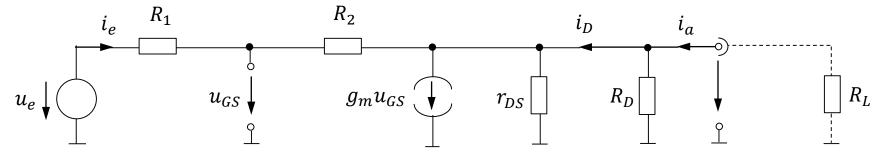
$$U_{a,A} = 2.5V \Longrightarrow I_{D,A} \approx \frac{U_b - U_{a,A}}{R_D} \approx 2.5mA$$

$$\Longrightarrow U_{GS,A} = U_T + \sqrt{\frac{2I_{D,A}}{\beta}} \approx 2.12V \Longrightarrow U_{e,A} \approx 2.06V$$





Kleinsignalersatzschaltbild der Sourceschaltung mit Spannungsgegenkopplung



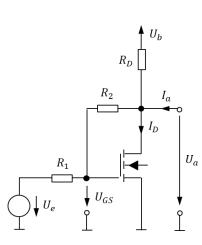
$$\frac{u_e - u_{GS}}{R_1} + \frac{u_a - u_{GS}}{R_2} = 0$$

$$g_m u_{GS} + \frac{u_a - u_{GS}}{R_2} + \frac{u_a}{r_{DS}} + \frac{u_a}{R_D} = i_a$$

mit $R'_D = R_D \parallel r_{DS}$ erhält man:

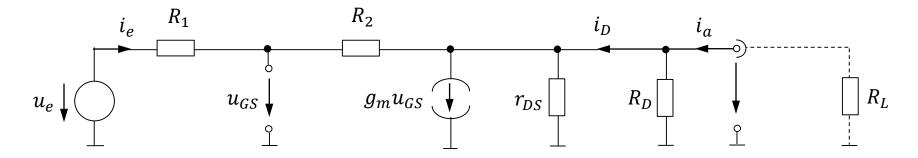
$$A = \frac{u_a}{u_e} \Big|_{i_a = 0} = \frac{-g_m R_2 + 1}{1 + g_m R_1 + \frac{R_1 + R_2}{R_D'}} \qquad \begin{array}{c} r_{DS} \gg R_D \\ R_1, R_2 \gg 1/g_m \\ \approx \end{array}$$

$$r_{DS} \gg R_D$$
 $R_1, R_2 \gg 1/g_m \sim -\frac{R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{g_m R_D}}$









Leerlaufeingangswiderstand (mit $R'_D = R_D || r_{DS}$):

$$r_{e,L} = \frac{u_e}{i_e}\Big|_{i_a=0} = R_1 + \frac{R_2 + R_D'}{1 + g_m R_D'}$$
 $r_{DS} \gg R_D \gg 1/g_m \approx R_1 + \frac{1}{g_m} \left(1 + \frac{R_2}{R_D}\right)$

Kurzschlussausgangswiderstand (mit $R'_D = R_D || r_{DS}$):

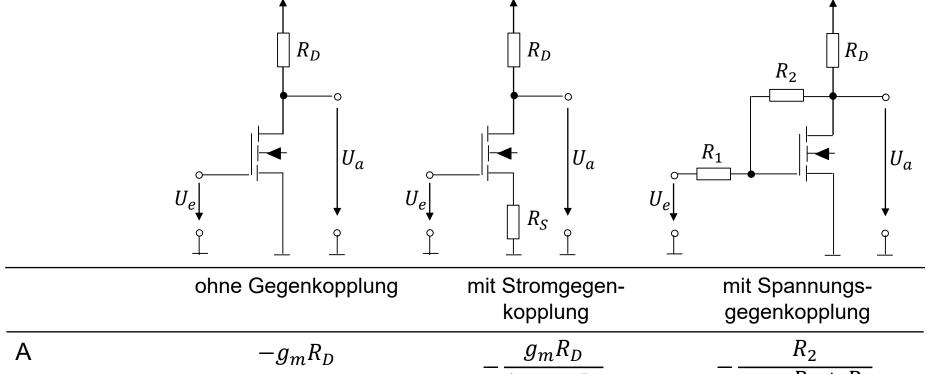
$$r_{a,K} = \frac{u_a}{i_a} \Big|_{u_e = 0} R_D' \| \frac{R_1 + R_2}{1 + g_m R_1} \qquad \begin{array}{c} r_{DS} \gg R_D \\ R_1 \gg 1/g_m \end{array} \qquad R_D \| + \frac{1}{g_m} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Leerlaufausgangswiderstand:

$$r_{a,L} = \frac{u_a}{i_a} \Big|_{i_a=0} R_D' \| \frac{1}{g_m} \qquad r_{DS} \gg R_D \gg 1/g_m \qquad \frac{1}{g_m}$$

Varianten der Sourceschaltung

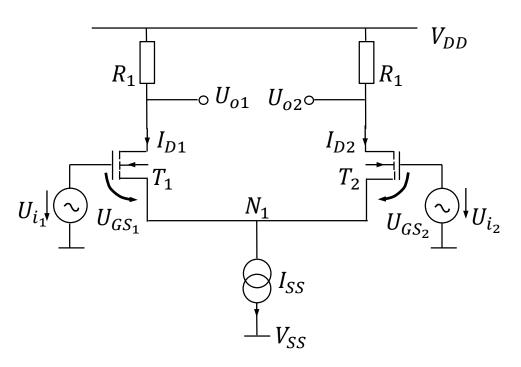




A $-g_m R_D$ $-\frac{g_m R_D}{1+g_m R_S}$ $-\frac{R_2}{R_1+\frac{R_1+R_2}{g_m R_D}}$ r_e ∞ ∞ $R_1+\frac{1}{g_m}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$ r_a R_D R_D R_D R_D

Aufbau und Betrieb einer MOSFET-Differenzstufe





- besteht aus zwei gleichen Eingangsstufen ($\beta_1=\beta_2$, $U_{T1}=U_{T2}$...) und einer idealen Stromquelle
- zwei Eingänge und zwei Ausgänge: U_{i1} , U_{i2} und U_{o1} , U_{o2}
- Source-Potentiale am Knoten N_1 nicht konstant, da Stromquelle I_{SS} vorhanden $\rightarrow U_i \neq U_{GS}$

Aufbau und Betrieb einer MOSFET-Differenzstufe



- **)** gilt immer: $I_{D1} + I_{D2} = I_{SS}$
-) wenn $U_{i1}=U_{i2}$ $\rightarrow I_{D1}=I_{D2}=\frac{I_{SS}}{2}$ aufgrund von Symmetrie

Annahme: $U_{i2} = const.$ und U_{i1} steigt:

 $\rightarrow I_{D1}$ steigt und I_{D2} sinkt

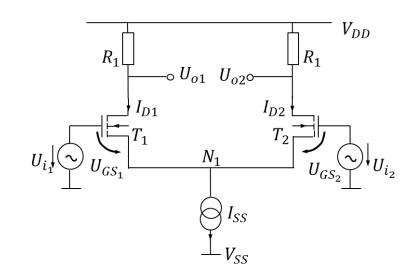
$$\rightarrow$$
 $-U_{i1} + U_{GS1} - U_{GS2} + U_{i2} = 0$

$$\rightarrow U_{GS1} - U_{GS2} = U_{i1} - U_{i2}$$

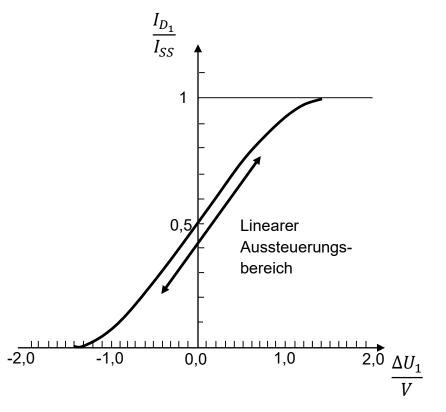
mit:
$$U_{GS1} = \sqrt{\frac{2 \cdot I_D}{\beta}} + U_T(U_{SB})$$

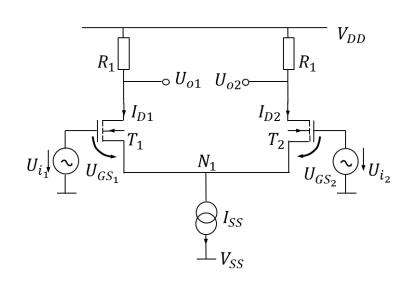
folgt mit
$$U_{T1} = U_{T2} \rightarrow U_{i1} - U_{i2} = \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D1}}{\beta}} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D2}}{\beta}}$$

und mit $\Delta U_i = U_{i1} - U_{i2} = \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D1}}{\beta}} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D2}}{\beta}}$



Aufbau und Betrieb einer MOSFET-Differenzstufe





$$I_{SS} = 100 \mu A$$

$$U_{SB1,2} > 0 \rightarrow U_{T1,2} > U_{T0}$$

 I_{D1} hängt von ΔU_i und I_{SS} ab